

# 大型重量部品対応

## 大型BGAを安定した品質で実装可能！ “サーバー業界トレンドに対応”

### お困りごと

#### ■基板実装、搭載部品の変化

高速通信

自動運転

生成AI



高性能な半導体PKG需要の高まり

大型重量化

高精細化

高額化

#### ■製造現場のお困りごと

- ・大型重量部品への対応力
- ・実装品質確保
- ・高額部品の廃棄ロス低減

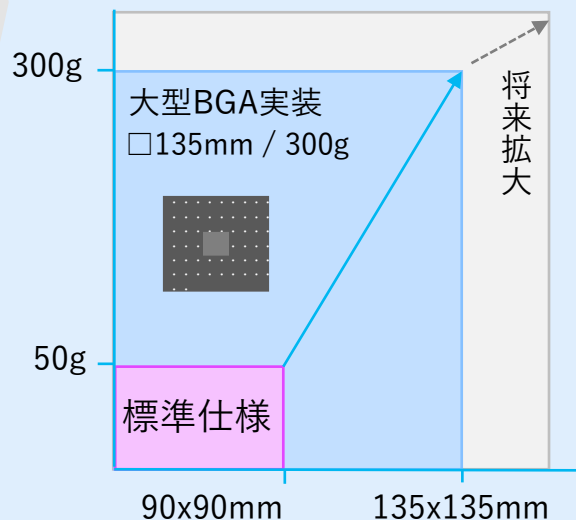


### ライセンス導入後の効果

#### ■多種多様な部品への対応力強化

- ・大型BGA実装に対応
- ・サイズ最大135x135mm、重量最大300g
- \*NPM-GW：□90 mm 超～□120 mmのみ最大350 g

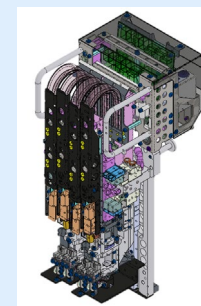
#### ■実装対応拡大



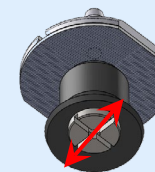
#### ■専用ノズル

- ・ノズルヘッドの改造無しで対応
- ・部品サイズと重量毎に最適なノズルをご提案します

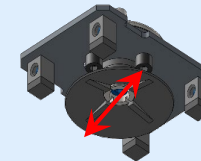
3NH V2



#3451 nozzle



#6617 nozzle



# 大型重量部品対応

大型BGAを安定した品質で実装可能！ “サーバー業界トレンドに対応

## ■ご使用上の注意点

1. 部品の吸着可否は、確保できる吸着面の大きさ、部品の寸法や質量、重心位置などの要素が影響するため、形状によっては吸着できない場合があります。サンプルによる検討、実験を行い、事前に装着可否の判断が必要です
2. 6617・6617N ノズルを使用する場合は、専用のノズルチェンジャーが必要です
3. その他注意点詳細は、取扱説明書、仕様説明書をご参照ください

## ■対象モデル

NPM-W2

NPM-TT2

NPM-WX：3ノズルヘッドV2

NPM-GW：FC03ヘッド

## ■制約事項

NPMシリーズ：V10.16.35H以降

NPM - Xシリーズ：V02.16.02E以降

\* 詳細はお問い合わせください